

锦州神工半导体股份有限公司

关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”或“公司”）拟终止实施公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”，并将节余募集资金 131,946,959.87 元（含利息收入和现金管理收益，实际转出金额以转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

● 本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）对该事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许〔2023〕2051号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税的发行费用人民币 3,943,396.22 元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕110Z0012 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上情况详见 2023 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

截至目前，本次拟终止的募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”。募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募投项目名称	拟投入募集资金 (A)	累积已投入募集资金 (B)	利息收入及现金管理收益净额 (C) 注	预计结余募集资金 (D=A-B+C)	项目进展情况
集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	20,905.66	8,231.33	520.37	13,194.70	拟终止
补充流动资金	8,700.00	8,748.11	48.11	0	已结项
合计	29,605.66	16,979.44	568.48	13,194.70	——

注：公司“补充流动资金”募投项目已按照相关规定使用完毕，公司已将中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行（账号：0708004329200669624）募集资金专户予以注销。详见公司于 2024 年 12 月 14 日发布的《关于部分募集资金账户注销的公告》。

二、本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明

（一）原计划投资和实际投资情况

基于审慎原则，结合目前市场环境、半导体行业发展趋势及发展战略与实际情况，公司拟终止本次募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”。

截至 2026 年 1 月 23 日，本项目计划投资总额为 20,905.66 万元，已实际投入募投资金 8,231.33 万元，未使用募集资金为 13,194.70 万元（以上含募集资金利息收入及理财收益），募集资金投入进度 39.37%，未使用募集资金主要为建设投资部分。上述原募投项目未使用募集资金 13,194.70 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）将用于永久补充流动资金，本次事项不构成关联

交易。

（二）终止实施并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的原因

1、2023 年，公司决定实施“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”，是公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，经过充分论证制定的项目投资计划。但鉴于以下原因，公司拟终止原募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金：

（1）全球市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化

公司采取的“逆周期投资”策略，是基于行业历史经验证明行之有效的策略。旨在抓住行业周期下行期的时间窗口，降低扩产成本，以抓住下一轮周期上升期快速增长的需求，扩大竞争优势。

2024 年以来，全球半导体市场有所回暖，但结构性特征却极为显著，且其背后驱动力与以往周期大相径庭：终端需求的来源，并非消费者对智能手机、个人电脑等电子产品的日常消费，而是科技巨头企业为提供人工智能服务而竞相投入的资本开支，在产业历史上尚属首次。

因此，半导体各细分市场的景气度高度分化。与消费电子相关的成熟市场仍处于萧条期，而与人工智能相关的新兴高端市场却供不应求，景气度高涨。

公司刻蚀设备用硅材料产品处于供应链的上游，受到全球半导体市场的整体景气度影响，且存在滞后性。考虑到景气度较高的新兴高端市场本质仍为利基市场，其销售额占整体市场相对较小，因此半导体市场整体景气度恢复的时间晚于最初预测，该业务的产能利用率未达预期。

（2）中国市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化

2024 年以来，中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛，已经在前沿技术和市场份额两方面紧跟海外竞争对手，改变了既有的全球产业格局；中国芯片制造国产化进程进入“深水区”，供应链安全需求迫切，国产设备厂商技术水平不断提升并追赶世界先进水平，产品持续迭代升级。

公司硅零部件产品，作为刻蚀设备用硅材料的制成品，是刻蚀工艺的核心耗材，受到国产化需求带动，实现连续大幅增长。硅零部件收入从 2023 年的 3,764 万元增长至 2024 年的 11,849 万元，2025 年上半年即达到 11,231 万元并超过了刻蚀设备用硅材料收入规模，同时带动了公司境内销售占比持续超过境外销售。

因此，一方面，硅零部件业务作为公司的第二曲线，加强了公司的成长性；另一方面，迅速扩张的生产规模也对公司水电气等基础设施配套以及人才梯队建设提出更高要求，需要资金投入。

公司基于以上市场变化并综合考虑各方面因素，以保护股东利益和提高资金使用效率为核心，审慎决定不再继续投入原募投项目。

2、公司在本次募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，形成资金节余。

3、在募投项目建设过程中，公司为提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

4、该项目存在尚未支付的尾款及质保金，系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长，在项目建设完成时尚未支付所致，从而现阶段形成一定节余。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定支付。

（三）节余募集资金的使用计划

为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司将持续精研技术、提高管理水平，抓住时间窗口，迎接下一轮半导体上行周期不断扩大的下游需求，巩固公司在全球范围内的竞争地位，满足公司战略发展的需要。

随着公司业务规模的扩张，为进一步提高募集资金使用效率，提高企业经济效益并降低财务费用，公司拟将本次募投项目终止后的节余募集资金131,946,959.87元转入公司一般银行账户永久补充流动资金（含利息收益，实际金额以相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准），用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

上述永久补充流动资金事项实施完成后，项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销设立在招商银行股份有限公司锦州分行的募集资金专户，公司与招商银行股份有限公司锦州分行以及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次募投项目终止后，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结

项。

本次拟注销募集资金专户及理财专用结算账户如下：

账户名称	开户银行	募集资金专户账号	账户状态
锦州神工半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司锦州分行	416900037710703	本次注销
锦州神工半导体股份有限公司	中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	已注销

三、对公司的影响及风险提示

本项目终止有利于合理利用募集资金，提高资金使用效率，不会对募投项目及公司生产经营活动产生重大不利影响。本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。本次终止的募投项目已实施部分均已顺利落地并形成有效产能，相关产能已正式投入运营，对公司主营业务形成有效补充与协同支撑，为公司产能布局优化及可持续发展奠定了坚实基础，发挥了积极作用。

四、履行的决策程序

公司已于 2026 年 1 月 21 日、2026 年 1 月 23 日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，并将节余募集资金永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

经核查，保荐机构国泰海通认为：

公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。上述事项是根据公司已投情况及实际需求客观作出的决策，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等有关规定。

综上所述，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补

充流动资金事项无异议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日